（上接B090版）

15日更新了《管理制度》，并于2023年5月11日经本公司2022年年度股东大会审议通过。同时，公司及保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）于2021年8月10日与招商银行上海分行营业部、中信银行股份有限公司上海分行、中国银行上海市吴中路支行、上海银行闵行支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专项存储四方监管协议》，于2023年6月30日与招商银行上海分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年10月31日与上海银行闵行支行签署了《募集资金专项存储四方监管协议》，于2023年11月2日与招商银行上海分行营业部签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，于2023年11月3日与中国银行上海市吴中路支行、中信银行上海分行营业部签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2023年12月31日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

开户银行	银行账号	账户类型	存放余额（元）	备注
招商银行上海分行营业部	121939323310888	募集专户	0.00	已注销
招商银行上海分行营业部	121928744310666	募集专户	149,661,145.21	
中信银行股份有限公司上海分行	8110201013001344792	募集专户	13,556,878.70	
中信银行股份有限公司上海分行	8110201013501352188	募集专户	1,893,812.01	
中国银行上海市吴中路支行	439081861450	募集专户	2,157,005.53	
上海银行闵行支行	03004644696	募集专户	49,614,240.42	
上海银行闵行支行	03004644378	募集专户	53,534,705.81	
中信银行上海分行营业部	8110201012101685873	募集专户	2,211,908.97	
上海银行闵行支行	03005501767	募集专户	2,961,130.08	
中国银行上海市吴中路支行	446885714103	募集专户	56,288,058.80	
招商银行上海分行营业部	121939323310118	募集专户	21,334,188.60	
合计			353,213,074.13	

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年8月23日，本公司召开了第三届董事会十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投项目建设进度的前提下，继续使用不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。2023年8月17日，公司已将暂时补充流动资金60,000万元全部归还。

2023年8月18日，本公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。截至2023年12月31日止，公司暂时补充流动资金尚未归还金额为60,000万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年8月23日，本公司召开了第三届董事会十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高公司募集资金使用效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意使用额度不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，用于购买安全性高、流动性好的理财产品且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，单个理财产品的投资期限不超过12个月。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。

2023年8月18日，本公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高公司募集资金使用效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意使用额度不超过人民币13亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，单个理财产品的投资期限不超过12个月。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。

截至2023年12月31日止，公司用于购买现金管理产品的期末余额为85,400.00万元，未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。本公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

存放机构	产品名称	金额（元）	购买日	到期日	公司主体
上海银行	结构性存款	90,000,000.00	2023/12/12	2024/1/15	上海艾为电子技术股份有限公司
申万证券	龙鼎定制640期	50,000,000.00	2023/8/24	2024/8/20	上海艾为电子技术股份有限公司
中国银行	结构性存款	24,000,000.00	2023/6/30	2024/1/8	上海艾为电子技术股份有限公司
中国银行	结构性存款	26,000,000.00	2023/6/30	2024/1/9	上海艾为电子技术股份有限公司
中国银行	结构性存款	29,760,000.00	2023/12/1	2024/2/5	上海艾为电子技术股份有限公司
中国银行	结构性存款	32,240,000.00	2023/12/1	2024/2/6	上海艾为电子技术股份有限公司
中信银行	结构性存款	46,000,000.00	2023/11/30	2024/1/4	上海艾为电子技术股份有限公司
中信银行	结构性存款	10,000,000.00	2023/12/7	2024/1/8	上海艾为电子技术股份有限公司
中信银行	结构性存款	30,000,000.00	2023/12/7	2024/3/8	上海艾为电子技术股份有限公司
上海银行	结构性存款	40,000,000.00	2023/11/28	2024/1/29	上海艾为半导体技术有限公司
上海银行	结构性存款	120,000,000.00	2023/12/12	2024/6/17	上海艾为半导体技术有限公司
上海银行	结构性存款	120,000,000.00	2023/12/12	2024/1/15	上海艾为半导体技术有限公司
上海银行	结构性存款	70,000,000.00	2023/12/14	2024/3/13	上海艾为半导体技术有限公司
上海银行	结构性存款	55,000,000.00	2023/12/26	2024/4/1	上海艾为半导体技术有限公司
中信银行	结构性存款	46,000,000.00	2023/11/30	2024/1/4	上海艾为微电子技术有限公司
上海银行	结构性存款	65,000,000.00	2023/12/5	2024/1/8	上海艾为微电子技术有限公司
合计		854,000,000.00			

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年12月31日止，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2023年4月13日，本公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用剩余全部超募资金47,220.00万元及其衍生利息、现金管理收益用于投资建设新项目。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。2023年5月11日，本公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》。

（七）节余募集资金使用情况

本公司分别于2023年10月26日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，于2023年11月14日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的议案》，同意对“研发中心建设项目”结项，公司拟将剩余募集资金18,932.47万元及其衍生利息、现金管理收益1,251.13万元，合计约20,183.60万元（具体金额以划拨日为准）用于公司募投项目“电子工程测试中心建设项目”，并调整募集资金投资项目“电子工程测试中心建设项目”的内部投资结构。调整后“电子工程测试中心建设项目”投资总额由73,858.20万元变更为94,041.80万元（具体金额以划拨日为准），募集资金承诺投资总额由73,858.20万元变更为94,041.80万元（具体金额以划拨日为准）。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。本公司于2023年12月5号进行了划拨，实际划拨金额为20,206.00万元，“电子工程测试中心建设项目”实际投资总额及募集资金承诺投资总额变更为94,063.20万元。

（八）募集资金使用的其他情况

1、超募资金用于回购公司股份

2022年8月23日，本公司召开了第三届董事会十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以公司超募资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股及/或股权激励计划，回购价格不超过180元/股（含），回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购实施期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。

截至2023年12月31日止，公司已完成回购股份，已使用超募资金人民币100,044,003.51元（含印花税、交易佣金等交易费用）。

2、募集资金使用过程中置换

2023年8月18日，本公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。本公司基于业务发展的实际情况，采用集中采购和支付的方式，即公司及子公司先以自有资金支付募投项目相关款项包括研发人员在募投项目的薪酬、材耗、试制测试、光罩、研发相关零星支出等，当月编制置换申请单，按照公司《募集资金管理制度》规定逐级审批后，由募集资金专项账户等额置换划转至公司及子公司的自有资金账户。

3、增加募投项目实施主体

2023年8月18日，本公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意增加全资子公司上海艾为微电子技术有限公司作为募投项目“智能音频芯片研发和产业化项目”、“5G射频器件研发和产业化项目”、“马达驱动芯片研发和产业化项目”及“高性能模拟芯片研发和产业化项目”的实施主体。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2023年12月31日止，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在其他未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，艾为电子2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了艾为电子2023年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：艾为电子2023年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2024年4月10日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海艾为电子技术股份有限公司　　2023年度

单位：人民币元

募集资金总额				3,035,261,414.64		本年度投入募集资金总额					357,050,647.27	
变更用途的募集资金总额				202,050,000.00		已累计投入募集资金总额					1,315,463,737.56	
变更用途的募集资金总额比例				6.66%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能音频芯片研发和产业化项目	否	441,645,900.00	441,645,900.00	441,645,900.00	103,962,382.80	297,302,366.55	-154,343,533.45	65.05	2025年8月	不适用	不适用	否
5G射频器件研发和产业化项目	否	211,770,529.19	211,770,529.19	211,770,529.19	30,189,768.82	113,200,961.15	-98,569,578.04	53.45	2025年8月	不适用	不适用	否
马达驱动芯片研发和产业化项目	否	367,891,167.57	367,891,167.57	367,891,167.57	67,987,436.24	172,817,173.30	-195,073,994.27	46.98	2025年8月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	是	408,247,600.00	206,197,600.00	206,197,600.00	1,948,291.28	218,922,897.29	12,725,297.29	106.17	2023年10月	不适用	不适用	否
电子工程测试中心建设项目	是	738,582,000.00	940,632,000.00	940,632,000.00	133,465,914.24	308,552,752.10	-632,079,247.90	32.80	2024年8月	不适用	不适用	否
发展与科技储备资金	否	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	8,590,127.36	109,052,537.96	-190,947,462.04	36.35	2025年8月	不适用	不适用	否
超募资金	不适用	567,124,217.88	100,044,003.51	100,044,003.51	5,345,670.03	100,044,003.51	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
高性能模拟芯片研发和产业化项目	否		467,080,214.37	467,080,214.37	5,571,055.70	5,571,055.70	-461,509,158.67	1.19	2026年6月	不适用	不适用	否
合计		3,035,261,414.64	3,035,261,414.64	3,035,261,414.64	357,050,647.27	1,315,463,737.56	-1,719,797,677.08					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		公司不存在项目可行性发生重大变化的情形										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不存在										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见说明三（三）										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		详见说明三（四）										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不存在										
募集资金结余的金额及形成原因		详见说明三（七）										
募集资金其他使用情况		详见说明三（八）										

注1：研发中心建设项目：截至期末累计投资金额超过承诺投资金额12,725,297.29元，投入进度超过100%，系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额投入募投项目所致。

注2：高性能模拟芯片研发和产业化项目：募集资金承诺投资总额467,080,214.37元不含首次公开发行人民币普通股(A股)股票的募集资金后续产生的衍生利息和现金管理收益。

注3：电子工程测试中心建设项目：原计划达到预订可使用状态日期为2024年8月，延期后达到预定可使用状态日期为2026年3月。公司于2023年1月通过招拍挂手续取得项目用地并签署土地出让合同，并于2023年4月取得以上募集资金投资项目用地的不动产权证。本项目设计方案于2023年10月通过审批，2023年11月份达到可以进场施工的状态。目前本项目处于基坑围护阶段。本项目立项后，因外部环境原因，无法与临港规资处有效沟通导致拿地方案的审批推迟，亦无法与政府部门各委办单位有效沟通导致并联征询批复意见延缓。在取得产证后根据主管部门对用地地块的设计要求，设计单位重新对施工图进行调整修改，建设规模超过原先体量，项目新增设计两层地下室，整体施工周期增加，并需要主管部门对设计方案及施工组织方案重新进行专家评审，导致项目建设周期拉长，本项目投产时间也将随之顺延。2024年4月8日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目延期和部分募投项目内部投资结构调整及增加募投项目实施主体的议案》。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：上海艾为电子技术股份有限公司　　2023年度

单位：人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
电子工程测试中心建设项目	电子工程测试中心建设项目	940,632,000.00	940,632,000.00	133,465,914.24	308,552,752.10	32.80	2024年8月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	研发中心建设项目	206,197,600.00	206,197,600.00	1,948,291.28	218,922,897.29	106.17	2023年10月	不适用	不适用	否
合计		1,146,829,600.00	1,146,829,600.00	135,414,205.52	527,475,649.39					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		由于“电子工程测试中心建设项目”的建设周期长、技术挑战多、开发复杂度高，需要配备大量高素质技术人员，同时建设测试生产线，提升公司芯片测试的产能，确保公司在未来半导体发展的同势中占据行业主导地位。公司拟将“研发中心建设项目”结项后的剩余募集资金18,932.47万元及其衍生利息、现金管理收益，用于“电子工程测试中心建设项目”。 公司分别于2023年10月26日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，于2023年11月14日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的议案》，同意将“研发中心建设项目”投资总额由40,824.76万元变更为21,892.29万元，使用募集资金拟投入金额由40,824.76万元变更为21,892.29万元，为进一步提高募集资金使用效率拟将“研发中心建设项目”调整后的剩余募集资金用于公司募投项目“电子工程测试中心建设项目”，公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年10月26日在上海证券交易所网站披露的《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的公告》（公告编号：2023-053）。									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		不存在								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		公司不存在项目可行性发生重大变化的情形								

证券代码：688798　证券简称：艾为电子　公告编号：2024-015

上海艾为电子技术股份有限公司关于2024年度申请综合授信额度并提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 为满足日常生产经营与业务发展需求，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟在《关于2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》（以下简称“本议案”）经2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止的期间内，向银行等金融机构申请总额不超过人民币35亿元（或等值外币）的综合授信额度，并为公司合并报表范围内的子公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币30亿元（或等值外币）的担保额度。该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司、孙公司）之间进行调剂；
- 被担保人为公司全资子公司，分别为AWINIC TECHNOLOGY LIMITED、上海艾为半导体技术有限公司、上海艾为微电子技术有限公司、深圳艾为集成电路技术有限公司、上海艾为集成电路技术有限公司、无锡艾为集成电路技术有限公司、苏州艾为集成电路技术有限公司；
- 截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额人民币21,359.46万元；
- 本次担保是否有反担保：否；
- 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情况；
- 本次申请综合授信额度并提供担保事项尚需经股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足日常生产经营与业务发展需求，公司及子公司拟在本议案经2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止的期间内，向银行等金融机构申请总额不超过人民币35亿元（或等值外币）的综合授信额度，并为公司合并报表范围内的子公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币30亿元（或等值外币）的担保额度。

上述担保额度预计将在下表所列公司合并报表范围内的子公司（包括但不限于）之间分配：

序号	被担保人	担保额度	公司持股比例（%）
1	AWINIC TECHNOLOGY LIMITED	人民币（或等值外币）6亿元	100
2	上海艾为半导体技术有限公司	人民币（或等值外币）10亿元	100
3	上海艾为微电子技术有限公司	人民币（或等值外币）3亿元	100
4	深圳艾为集成电路技术有限公司	人民币（或等值外币）1亿元	100
5	上海艾为集成电路技术有限公司	人民币（或等值外币）8亿元	100
6	无锡艾为集成电路技术有限公司	人民币（或等值外币）1亿元	100
7	苏州艾为集成电路技术有限公司	人民币（或等值外币）1亿元	100

上述综合授信额度拟用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、并购贷款、合同融资、贸易融资、供应链融资、开具银行承兑汇票、开具信用证、开具保函、汇票贴现、融资租赁等业务。该等授信额度不等于实际融资金额，最终融资金额以公司及子公司与金融机构签订的相关协议及实际发生额为准。

公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司、孙公司）申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供担保的方式包括保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，具体担保期限以届时签订的担保合同为准。上述申请综合授信额度及提供担保事项经公司股东大会审议通过后，股东大会授权董事长根据实际需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，就具体申请授信或提供担保事项作出决定并签署相关法律文件，授权公司经营管理层办理相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

二、被担保人基本情况

（一）AWINIC TECHNOLOGY LIMITED

成立日期：2014-07-31

注册地址：4TH FLOOR WORLD TRADE SQUARE,21 ON LOK MUN STREET,FANLING,HK

董事：孙洪军、郭辉

经营范围：集成电路芯片的销售。

子公司类型：全资子公司，股权结构为公司100%持股。

主要财务数据：

单位：万元　币种：美金

类别	2023年12月31日/2023年度
资产总额	7,854.52
负债总额	8,229.29
资产净额	-374.77
营业收入	33,923.32
净利润	-921.10
扣除非经营损益后的净利润	-928.81

注：以上2023年度财务数据未经审计

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

（二）上海艾为半导体技术有限公司

成立日期：2020-08-26

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

法定代表人：孙洪军

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；通信设备销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；报关业务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

子公司类型：全资子公司，股权结构为公司100%持股。

主要财务数据：

单位：万元　币种：人民币

类别	2023年12月31日/2023年度
资产总额	120,350.50
负债总额	24,243.39
资产净额	96,107.11
营业收入	66,445.42
净利润	889.34
扣除非经营损益后的净利润	413.98

注：以上2023年度财务数据未经审计

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

（三）上海艾为微电子技术有限公司

成立日期：2020-09-02

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海洋四路99弄1、5号8层

法定代表人：孙洪军

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；通信设备销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；报关业务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

子公司类型：全资子公司，股权结构为公司100%持股。

主要财务数据：

单位：万元　币种：人民币

类别	2023年12月31日/2023年度
资产总额	4,690.56
负债总额	8,229.29
资产净额	-374.77
营业收入	33,923.32
净利润	-921.10
扣除非经营损益后的净利润	-928.81

注：以上2023年度财务数据未经审计

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

（四）深圳艾为集成电路技术有限公司

成立日期：2021-12-22

注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留仙大道创智云城1标段1栋D座2901

法定代表人：孙洪军

经营范围：一般经营项目是：集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

子公司类型：全资子公司，股权结构为公司100%持股。

主要财务数据：

单位：万元　币种：人民币

类别	2023年12月31日/2023年度
资产总额	11,412.38
负债总额	6,721.82
资产净额	4,690.56
营业收入	3,177.41
净利润	-330.77
扣除非经营损益后的净利润	-330.83

注：以上2023年度财务数据未经审计

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

（五）上海艾为集成电路技术有限公司

成立日期：2016-08-31

注册地址：上海市闵行区秀文路908弄2号1202室

法定代表人：孙洪军

经营范围：从事集成电路、电子通信专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、通信器材的销售，从事货物及技术的进出口业务，集成电路设计，办公用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

子公司类型：全资子公司，股权结构为公司100%持股。

主要财务数据：

单位：万元　币种：人民币

类别	2023年12月31日/2023年度
资产总额	2,013.00
负债总额	396.49
资产净额	1,617.51
营业收入	1,129.59
净利润	222.11
扣除非经营损益后的净利润	219.99

注：以上2023年度财务数据未经审计

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

（六）无锡艾为集成电路技术有限公司

成立日期：2018-10-15

注册地址：无锡市新吴区弘毅路10号金乾座1601-1610室

法定代表人：孙洪军

经营范围：集成电路、电子通信专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子产品、通信器材的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；集成电路设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

子公司类型：全资子公司，股权结构为公司100%持股。

主要财务数据：

单位：万元　币种：人民币

类别	2023年12月31日/2023年度
资产总额	53,005.67
负债总额	17,589.18
资产净额	35,416.49
营业收入	7,860.28
净利润	-5,690.66
扣除非经营损益后的净利润	-6,311.56

注：以上2023年度财务数据未经审计

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

（七）苏州艾为集成电路技术有限公司

成立日期：2019-08-05

注册地址：苏州工业园区金鸡湖大道88号G2-2201单元

法定代表人：孙洪军

经营范围：集成电路、电子通信技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子产品、通信器材的销售；集成电路设计；从事上述货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

子公司类型：全资子公司，股权结构为公司100%持股。

主要财务数据：

单位：万元　币种：人民币

类别	2023年12月31日/2023年度
资产总额	1,726.85
负债总额	405.17
资产净额	1,321.68
营业收入	1,934.67
净利润	151.56
扣除非经营损益后的净利润	146.54

注：以上2023年度财务数据未经审计

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划担保额度尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由公司法定代表人（或其书面授权代表）签署上述担保额度内的担保合同等各项法律文件。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司业务情况进行的预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，确保公司经营工作顺利进行，担保风险总体可控。

五、审批程序

公司于2024年4月8日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

公司监事会认为，公司及子公司向银行等金融机构申请授信，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，对公司日常经营具有积极影响。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对被担保对象具有形式上和实质上的控制权，风险总体可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意该议案提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及全资子公司不存在为第三方提供担保的事项。截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额人民币21,359.46万元，均为公司对合并报表范围内的全资子公司提供的担保，占上市公司最近一期经审计净资产（归属于母公司所有者权益）和总资产的比例分别是5.90%和4.33%。

公司无逾期担保的情况。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2024年4月10日

证券代码：688798　证券简称：艾为电子　公告编号：2024-016

上海艾为电子技术股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 现金管理金额和品种：公司及子公司使用额度不超过等值人民币20亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或结构化存款。在额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
- 履行的审议程序：2024年4月8日公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理购买理财产品。
- 相关风险提示：虽然选择低风险投资品种的理财产品，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司及全资子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用额度不超过等值人民币20亿元的闲置自有资金购买理财产品，购买流动性好、低风险（风险等级评级为R2)的稳健型理财产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品的概况

（一）投资产品的目的

在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，提高闲置自有资金的使用率，合理利用自有资金，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品的品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分自有资金用于购买流动